

仕様変更のご案内

RJシリーズ スリムパワーリレー（プリント基板用端子タイプ）

RJシリーズ スリムパワーリレー（プリント基板用タイプ）の端子部の表面処理追加についてご案内いたします。

実施時期

2009年11月より順次導入

対象機種

RJシリーズ プリント基板用端子タイプ 全機種

変更内容

端子部の表面処理を追加いたします。

表面処理	変更前	変更後
端子	スズメッキ	スズメッキ 鉛フリーハンダ処理

表面処理追加に伴い、端子部の外形寸法を変更いたします。
但し、プリント基板用加工寸法（φ1.3穴）に変更はありません。

外形寸法	変更前	変更後
端子幅	1.0mm	1.1mm
コイル端子厚さ	0.5mm	0.6mm
接点端子厚さ	0.3mm	0.4mm

※ 上記以外に、定格・仕様・外観の変更はありません。

その他

新旧混在でご使用いただいても性能上の問題はございません。